

# 2019 VLSI/CAD 研討會徵求參展作品 (Call for Demonstration)

## ◇ 有關 VLSI/CAD 研討會 (<http://www.vlsicad2019.org>)

此為台灣歷史最久與規模最大 VLSI/CAD 研討會。由 1988 年第一次舉辦迄今已有 29 屆，匯集來自台灣 IC 設計學術領域重量級學者與電子相關領域科系/研究所學生、業界人士，還有科技部、教育部等政府部門的代表共聚一堂，分享最新研發成果與技術趨勢。本屆 VLSI Design/CAD 大會也預計有將近千人參與，發表超過 150 篇研究論文。

## ◇ 徵求參展目的 -- 讓你的 **Idea** 遇見 **AI + IC**

有鑒於系統應用科技與積體電路關鍵零組件的關聯性密切，本次會議突破以往之學術論文討論，希望可建構上下游合作渠道，邀請已有產學成果的技職院校團隊來此研討會進行展示成果，讓『系統設計團隊』(Idea)可以與『演算法設計團隊』(AI)及『晶片設計團隊』(IC)或者透過對話產生合作的火花，除了提高應用系統的技術障礙度，也讓晶片設計可以真正落實於應用場域。

## ◇ 徵求參展團隊&主題

團隊: 技職院校團隊 (不限電子、電機、資工...科系) 已經有顯著之產學合作成果者

- ✓ 雛型設計已經多次獲得國內外創意/創業獎項，或
- ✓ 已經與產學合作廠商討論量產設計，或
- ✓ 已經獲得加速器/天使基金/創投青睞...投資

主題: 醫療電子、車用電子、與其他物聯網相關主題

## ◇ 參展時間 & 地點

參展時間: 2019/08/06 ~ 2019/08/09

地點: 高雄義大皇家酒店

攤位大小: 2m (寬) x 1 (深)

## ◇ 獲選團隊 義務與權力

義務: 於大會給予之攤位展出已有成果之雛型 (Prototype)或者商品(Product)

(參展師生 需註冊會議 至少兩人)

權利: 免費攤位費用 & 大會給予最佳展示商品獎(Best Demonstration Award)

## ◇ 報名方式

投稿期限: 2019/07/10

通知獲選: 2019/07/15 (暫定，遴選過程中會與團隊進一步溝通)

文件格式: (如附件)。請填妥附件資料後，逕 Email 寄 唐經洲 教授。

VLSI/CAD 2019 展示主席

南台科大 電子系 唐經洲

06-2533131-3149

[tjj@stust.edu.tw](mailto:tjj@stust.edu.tw)

- ◆ 以下格式僅為建議格式，參展團隊可以依據您的資料給予修訂
- ◆ 欄位內容字數不限
- ◆ 若有其它問題，請逕向 唐經洲 教授 詢問

## 2019 VLSI/CAD 研討會參展報名表

學校/科系:	(可以跨校/科系)
主要核心技術:	(可以多個)
作品/產品名稱:	(依據核心技術所衍伸之作品。展品可以多個，但請依序說明)
作品/產品描述	請說明您的作品 的應用場域與所解決的問題
獲獎比賽:	(請列出過去得獎歷史。歡迎有得獎團隊參加) (若有照片，請提供並解釋)
過去參展經驗:	(請列出過去參展歷史。歡迎有參展經驗團隊參加) (若有照片，請提供並解釋)
現有合作公司:	(與您產學合作 or 投資之 公司)
其他訊息	
期待合作的教授背景	<p>(請根據以下 原大會投稿主題 選擇 您希望對談的 教授背景)</p> <p><b>Analog &amp; RF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biomedical Circuits and Systems</li> <li>2. Data Converters</li> <li>3. Green Power Electronics Circuits and Systems</li> <li>4. PLLs, DLLs, and Wireline Transceivers</li> <li>5. RF/mm-Wave Circuits and Wireless Transceiver</li> <li>6. Sensors Interfaces, Imagers, Displays, and MEMS</li> <li>7. Others</li> </ol> <p><b>EDA &amp; Testing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DFT and Fault Modeling</li> <li>2. Mixed-Signal/RF/Memory/MEMS Test</li> <li>3. Physical-Level Synthesis/Optimization/Verification</li> <li>4. SiP/SOC Test/Reliability and Security</li> <li>5. System and Logic Level Modeling/Synthesis/Optimization/Verification</li> <li>6. Timing/Power/Thermal Optimization and DFM</li> <li>7. Others</li> </ol> <p><b>Digital &amp; System</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Communication Circuits and Systems</li> <li>2. Digital Circuits/FPGA Prototyping/Embedded System</li> <li>3. Multi-Core/NoC/ASIC Design</li> <li>4. Neural Networks and Neuromorphic Engineering</li> <li>5. Signal Processing ICs</li> <li>6. Artificial Intelligent Accelerator</li> <li>7. Others</li> </ol> <p><b>Emerging Technology</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Automotive Electronics/Systems</li> <li>2. Green Energy Systems</li> <li>3. Cloud Computing</li> <li>4. Intelligent Sensors</li> <li>5. Internet of Things</li> <li>6. Artificial Intelligent Circuits and Systems</li> <li>7. Lab-on-a-Chip</li> <li>8. Others</li> </ol>